

タツモ株式会社 決算説明資料

2022年12月期

2023年2月13日

タツモ株式会社



社名	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	34億9,540万538円
従業員数	単体 364名/連結 1,105名（2022年12月31日現在）



事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品などの開発・製造・販売
------	---

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売



搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットやアライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した製品等の開発・製造・販売



洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売



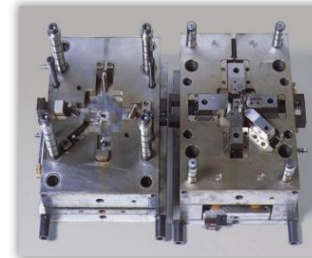
コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置、ナノインプリント製造装置、パネルレベルパッケージ製造の開発・製造・販売



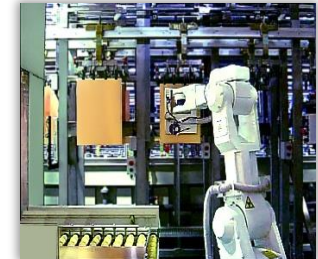
金型・樹脂成形事業

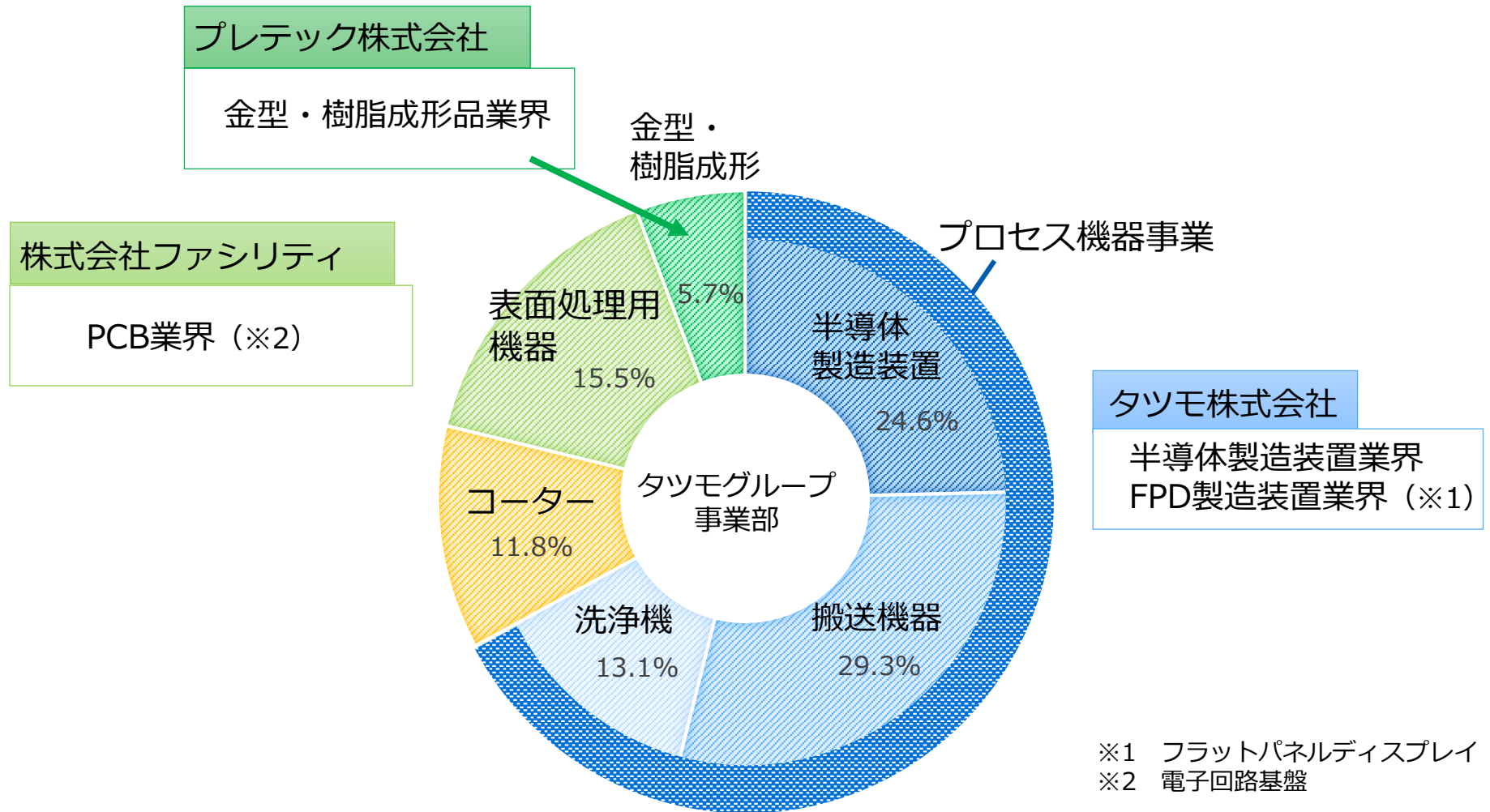
電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使ったコネクタ等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売



表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の開発・製造・販売





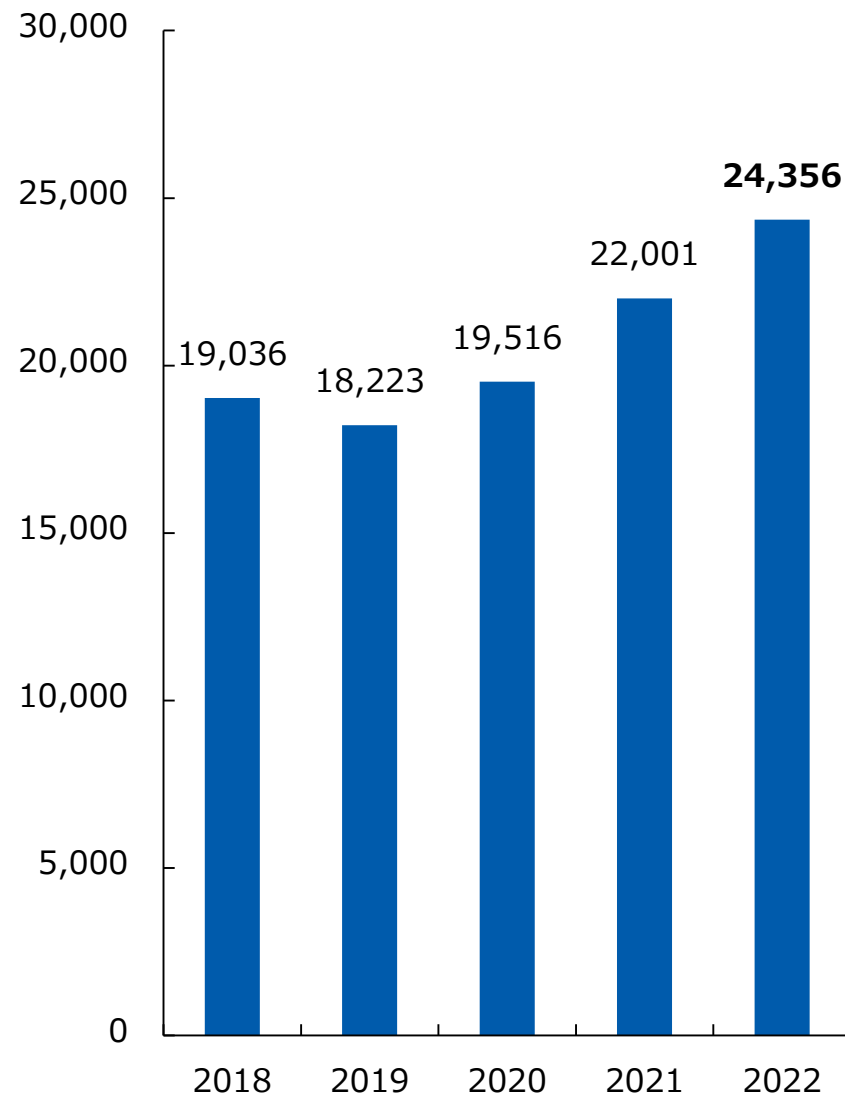
半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

単位:百万円	'21年 12月期	'22年 12月期	売上比 (%)	修正計画	計画比 (%)
売上高	22,001	24,356	—	26,133	93.2
売上総利益	5,933	7,328	30.1	—	—
販管費	3,841	4,521	18.6	—	—
営業利益	2,092	2,806	11.5	2,988	93.9
経常利益	2,218	3,138	12.9	3,396	92.4
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,749	2,263	9.3	2,412	93.8

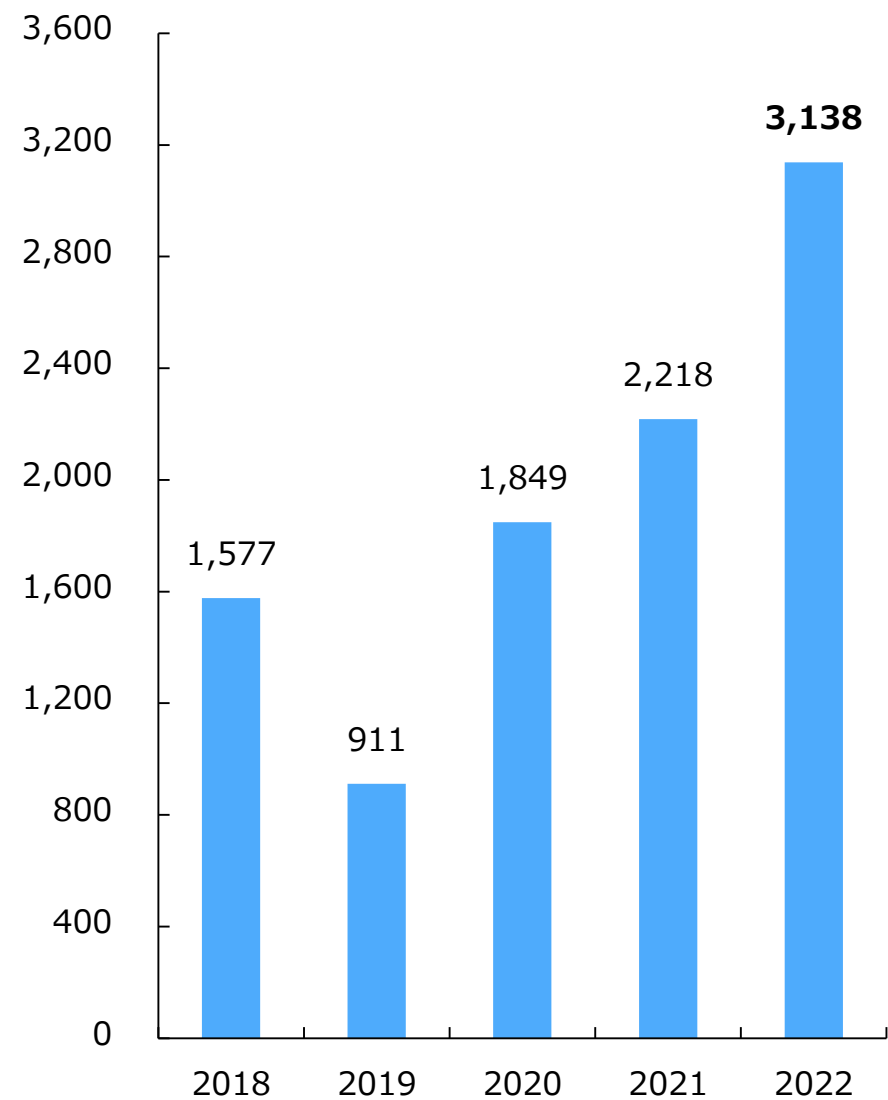
検収遅延の案件が重なり、売上・利益ともに修正計画は未達となったが、年初計画を上回り過去最高益を達成。

単位：百万円

売上高推移



経常利益推移



連結貸借対照表

単位：百万円	'21年12月期	'22年12月期	増減
流動資産	22,075	31,905	9,829
有形固定資産	5,870	6,286	415
無形固定資産	147	179	31
投資その他資産	1,295	1,025	△270
総資産	29,390	39,397	10,006
流動負債	13,457	18,463	5,005
固定負債	2,357	3,384	1,026
純資産	13,574	17,549	3,974
自己資本比率	45.5%	43.9%	△1.6P

主な増減			単位：百万円
資産			
	'22年4Q	前期末比	
現金及び預金	5,141	1,873	
受取手形及び売掛金	4,496	△979	
原材料及び貯蔵品	4,888	2,837	
仕掛品	13,032	3,772	
負債			
	'22年4Q	前期末比	
電子記録債務	4,350	1,861	
短期借入金	5,279	2,107	
前受金（契約負債）	3,691	320	
有償支給取引に係る負債	577	577	
長期借入金	2,643	990	

	'21年12月期	'22年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	336	△1,513
税金等調整前当期純利益	2,218	3,203
減価償却費	589	698
売上債権の増減額（△：増加）	△652	530
棚卸資産の増減額（△：増加）	△996	△6,415
仕入債務の増減額（△：減少）	646	1,542
前受金（契約負債）の増減額 （△：減少）	△1,443	228

	'21年12月期	'22年12月期
投資活動によるキャッシュ・フロー	△795	△669
定期預金の払戻による収入	—	190
有形固定資産の取得による支出	△470	△828
財務活動によるキャッシュ・フロー	523	4,098
長期借入による収入・短期借入金 の純増減	1,980	4,700
長期借入金の返済による支出	△1,229	△1,601
現金及び現金同等物に係る換算差額	167	128
現金及び現金同等物の増減額 (△：減少)	231	2,043
現金及び現金同等物の期末残高	2,981	5,024

単位：百万円	'21年 12月期	売上比 (%)	'22年 12月期	売上比 (%)	修正計画	計画比 (%)
売上高	22,001	—	24,356	—	26,133	93.2
プロセス機器事業	17,528	79.7	19,192	78.8	20,295	94.6
半導体装置	4,603	20.9	5,997	24.6	6,069	98.8
搬送機器	5,526	25.1	7,136	29.3	6,796	105.0
洗浄機	3,730	17.0	2,864	11.8	3,350	85.5
コーター	3,666	16.7	3,193	13.1	4,080	78.3
金型・樹脂成形事業	1,572	7.1	1,400	5.8	1,701	82.3
表面処理用機器事業	2,900	13.2	3,763	15.5	4,137	91.0

半導体装置：4Qに集中していた案件も順調に検収となり 前年同期比で30.3%増

搬送機器：通年で好調 ベトナム子会社も好調に推移 前年同期比29.1%増

洗浄機：検収遅れにより計画未達 スケジュール遅れ気味 前年同期比23.2%減

コーター：検収ずれ等により計画未達 ナノイン用置受注できず 前年同期比12.9%減

表面処理用機器：設備投資は回復 めっき装置以外の案件受注 前年同期比29.7%増

単位：百万円	'21年 12月期	売上比 (%)	'22年 12月期	売上比 (%)	修正計画	計画比 (%)
営業利益	2,092	9.5	2,806	11.5	2,988	93.9
プロセス機器事業	1,992	9.1	2,635	10.8	1,575	167.3
金型・樹脂成形事業	87	0.4	11	0.0	31	35.5
表面処理用機器事業	13	0.1	175	0.7	161	108.7
セグメント間連結消去	△1	—	△16	—	—	—

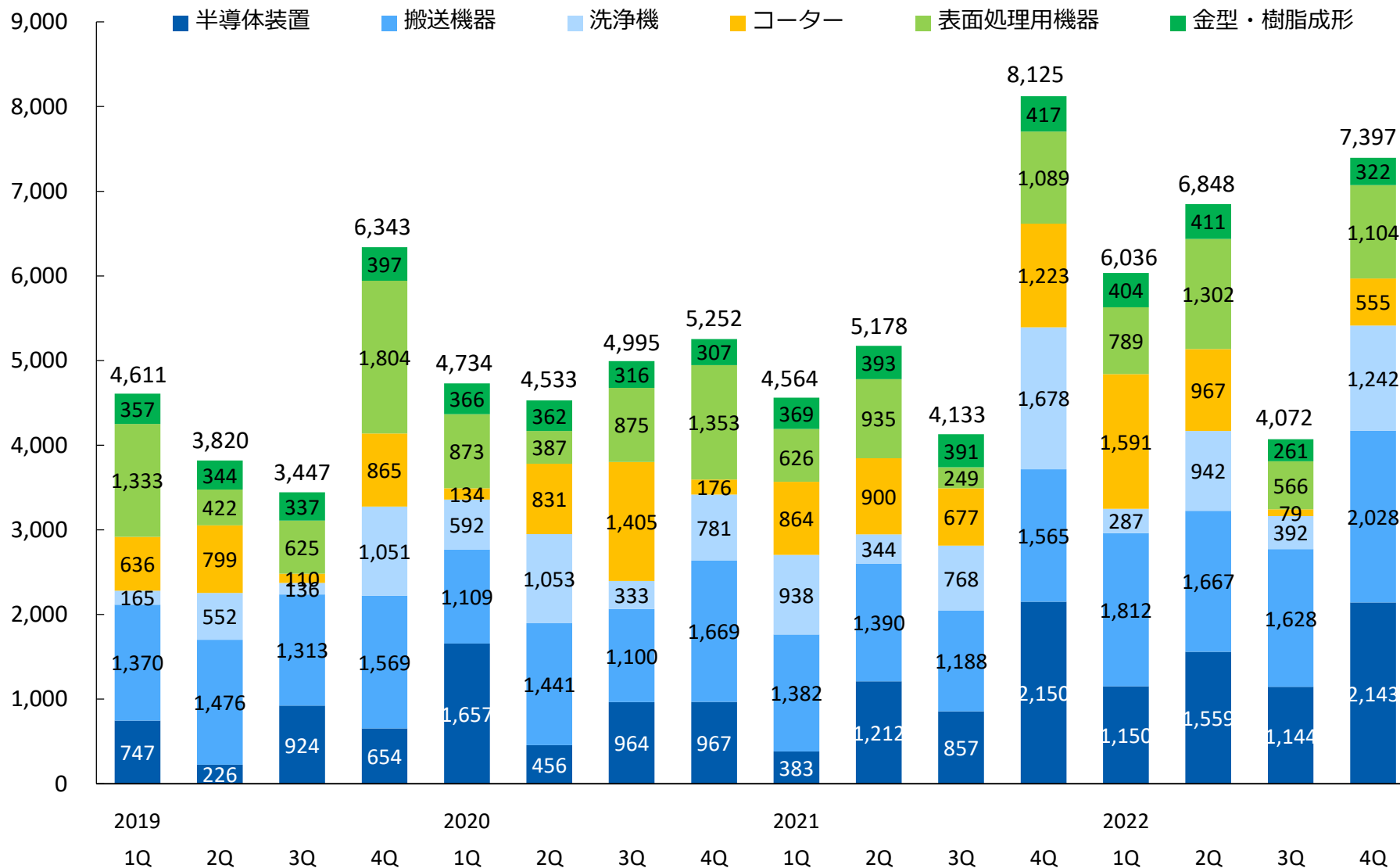
プロセス機器事業：半導体装置・搬送機器の売上増 量産効果等により前年同期比32.3%増

金型・樹脂成形事業：材料費高騰により利益率悪化 前年同期比86.8%減

表面処理用機器事業：売上は堅調に推移 利益率も回復 前年同期比1,191.7%増

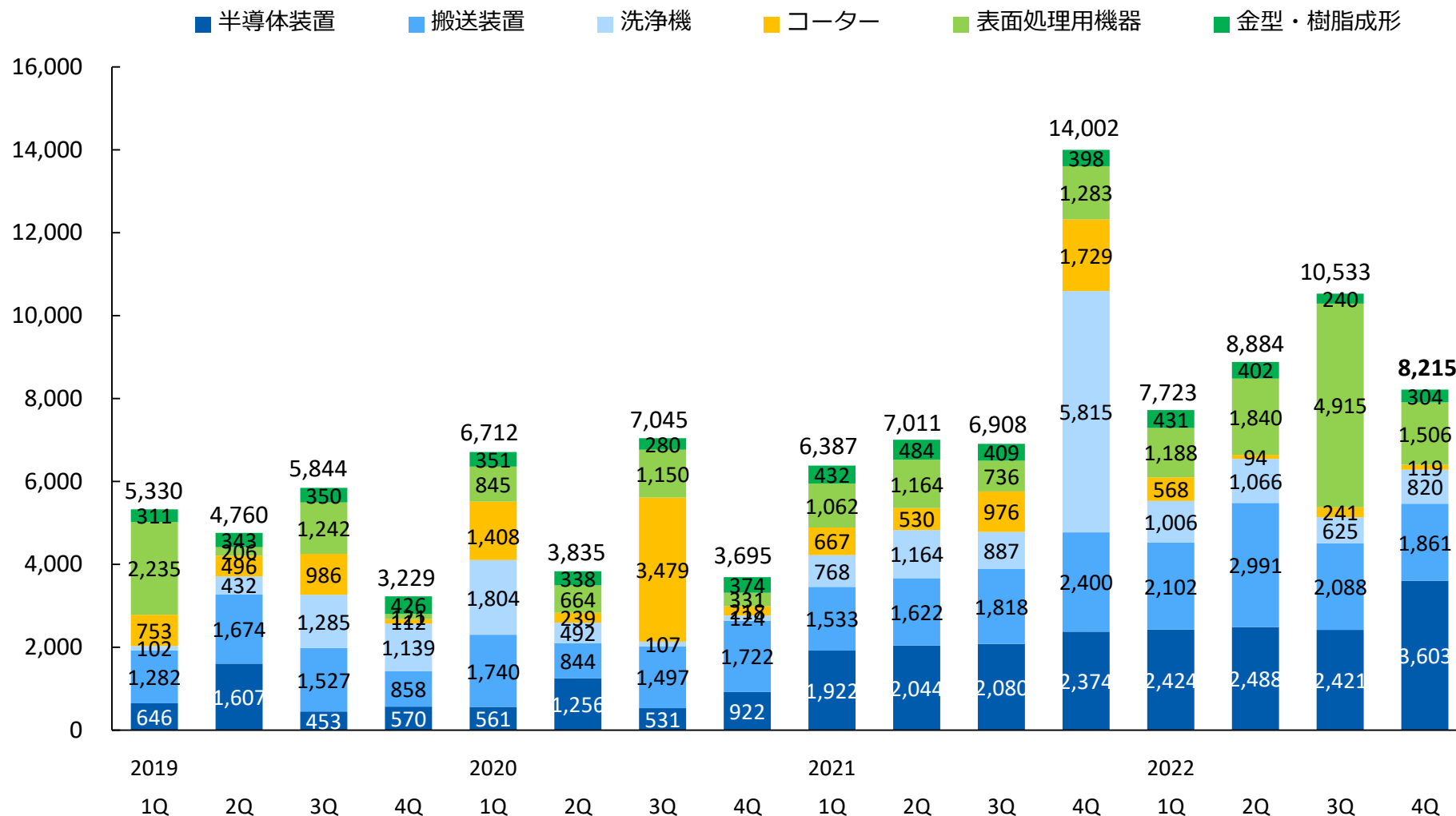
セグメント別 売上高推移

単位：百万円



セグメント別 受注高推移

単位：百万円



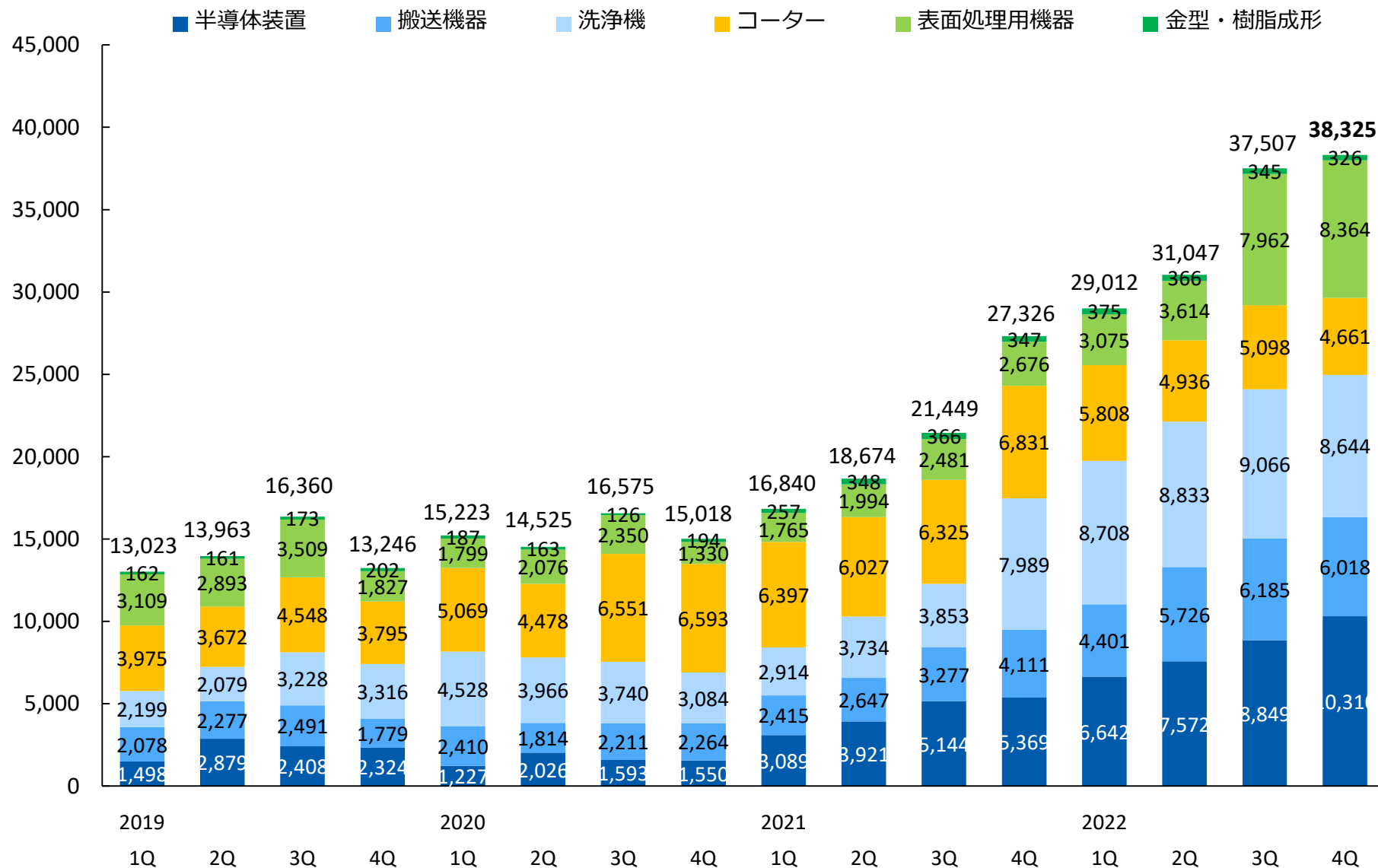
プロセス機器事業：半導体装置及び搬送機器の受注好調。強い引合が継続中。

表面処理用機器事業：引合・受注が回復傾向。

金型・樹脂成形事業：コネクタ関係の受注好調。

セグメント別 受注残高推移

単位：百万円

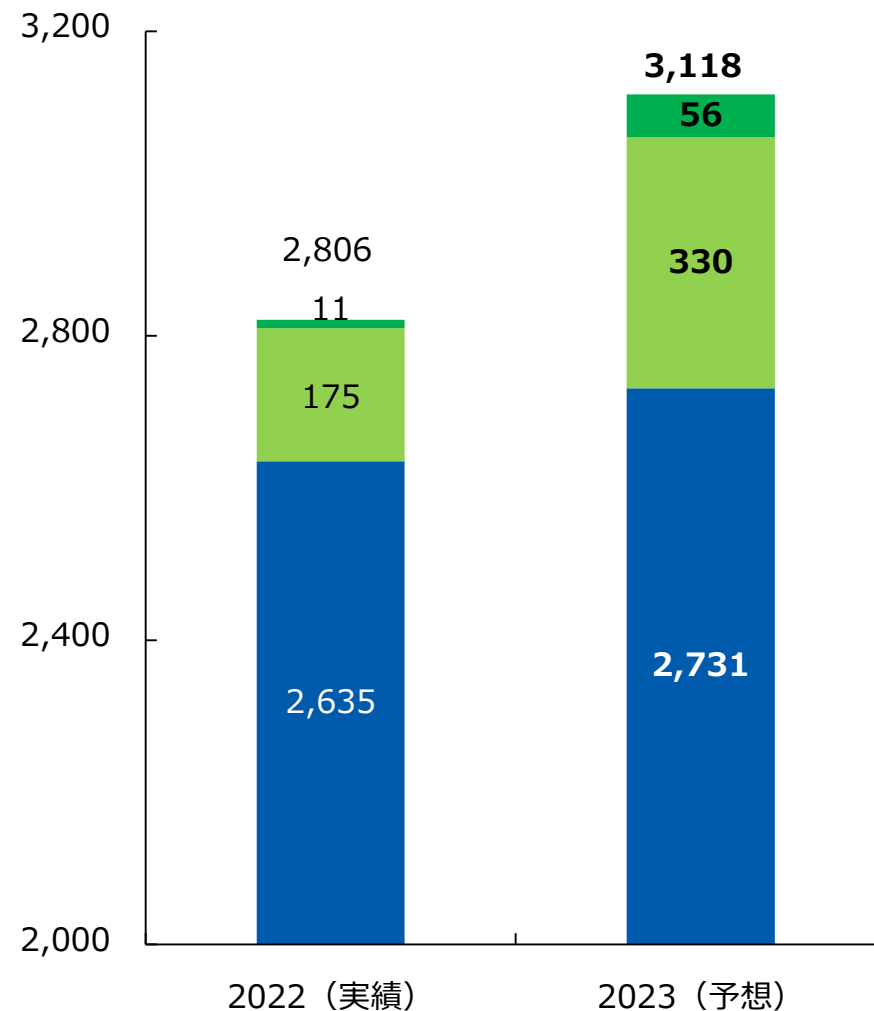
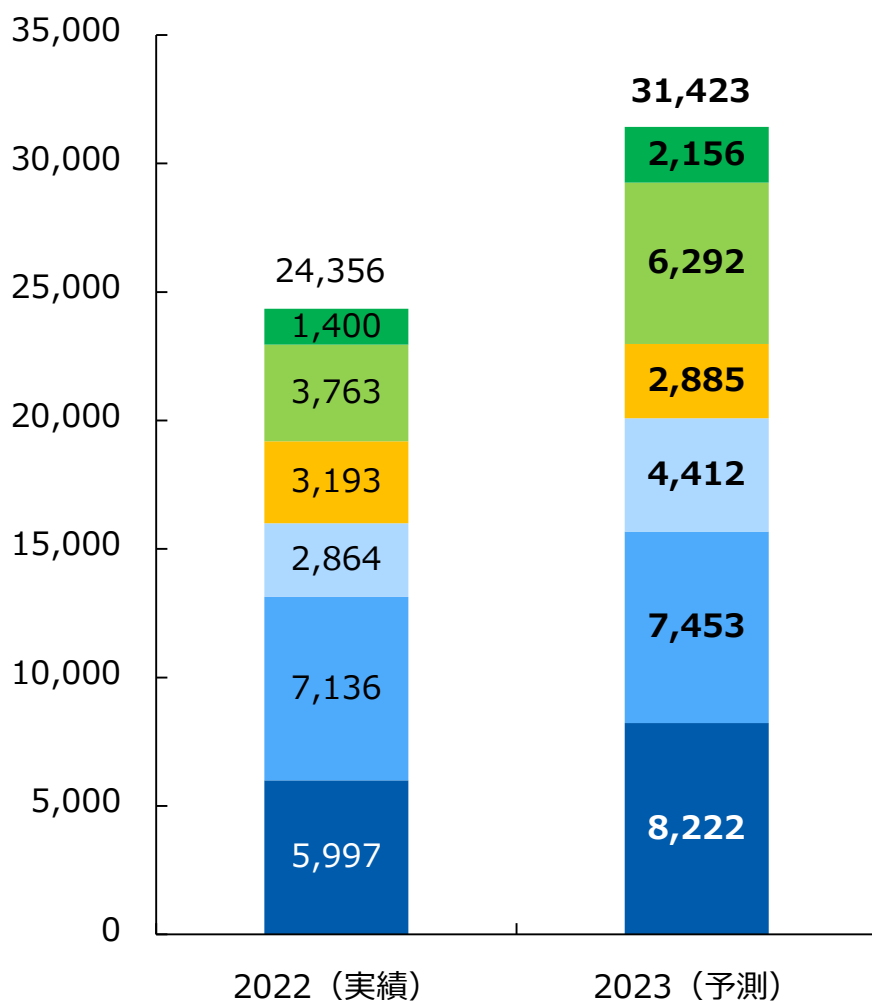


単位：百万円	第2四半期累計	通期	前期比 (通期増減)
売上高	13,610	31,423	7,067
プロセス機器事業	9,606	22,974	3,782
金型・樹脂成形事業	1,070	2,156	756
表面処理用機器事業	2,933	6,292	2,529
営業利益	1,187	3,118	312
プロセス機器事業	960	2,731	96
金型・樹脂成形事業	—	56	45
表面処理用機器事業	232	330	154
経常利益	1,170	3,087	△51
親会社株主に帰属する 当期純利益	800	2,109	△153

単位：百万円

売上高

営業利益



- 半導体装置
- 搬送機器
- 洗浄機
- コーター
- 表面処理用機器
- 金型・樹脂成形
- プロセス機器
- 表面処理用機器
- 金型・樹脂成形

単位：百万円

	2023年12月期	2024年12月期	2025年12月期
売上高	31,423	34,110	40,600
プロセス機器事業	22,974	25,167	32,355
半導体製造装置	8,222	9,778	12,700
搬送機器	7,453	8,252	9,365
洗浄装置	4,412	4,592	4,690
コーター	2,885	2,545	5,600
金型・樹脂成形事業	2,156	1,543	1,545
表面処理機器事業	6,292	7,400	6,700
経常利益	3,087	3,600	5,000
経常利益率	9.8%	10.6%	12.3%

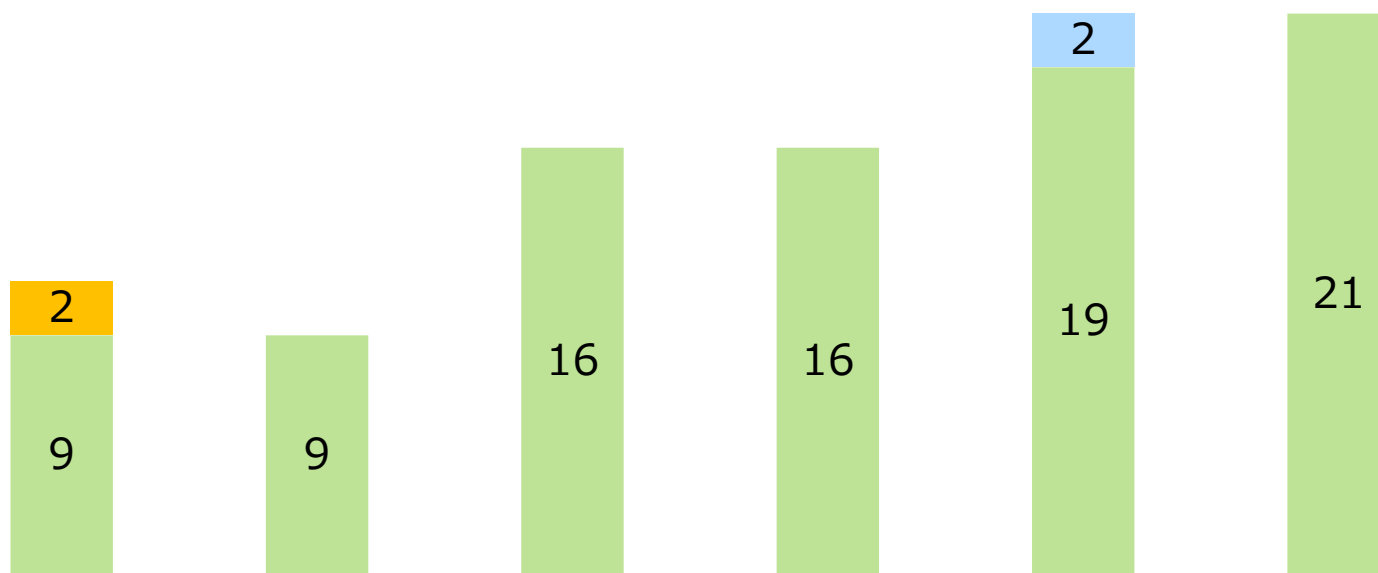
単位：百万円

	2023年12月期	2024年12月期	2025年12月期
半導体装置			
塗布／現像装置	400	1,300	2,000
貼合／剥離装置	6,500	5,900	7,500
紫外線照射装置	650	1,000	1,500
洗浄機			
洗浄装置	2,600	3,000	3,000
リン酸再生／ スラリー供給装置	1,500	1,000	1,000
コーター			
CF塗布装置	1,330	1,130	800
NIL装置 (ナノインプリント向)	485	—	3,000
PLP装置 (パネルレベルパッケージ向)	460	500	1,000

- パワー半導体／パッケージ用途で貼合/剥離装置の引合は引き続き強い。ロジック向け塗布／現像装置は軟調。
- 搬送機器も引き続き受注好調だが国内・中国向けが中心。韓国・台湾向けは低下。
- リン酸再生システムの引合が強い。確実に受注につなげる。
- ナノインプリント装置は新規の受注ができなかった。今後の計画に影響。
- 表面処理用機器は国内プリント基板メーカーの設備投資が回復。引合は強い。めっき処理装置以外の案件で大口径受注。
- 部品・材料の調達は今も引き続き困難な状況にある。新たに調達困難になっている部材も出てきている。
- 製造工程は今も引き続きひっ迫。生産管理・工程管理を強化し対応中。
- 材料の値上げについて受注済み案件に大きな影響はないが、今後の受注・利益に影響の懸念あり。
- 中国 紹興市へ子会社を設立。中国のコロナ事情などにとり建物の完成が遅延。

配当金の推移

■ 普通配当 ■ 一部上場記念配当 ■ 50周年記念配当



	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12 (予想)
当期純利益 (百万円)	1,479	726	1,693	1,749	2,263	2,109
1株当たり 配当金額 (円)	11.0	9.0	16.0	16.0	21.0	21.0
配当性向 (%)	8.9	16.6	12.6	12.1	13.0	13.9

補足資料





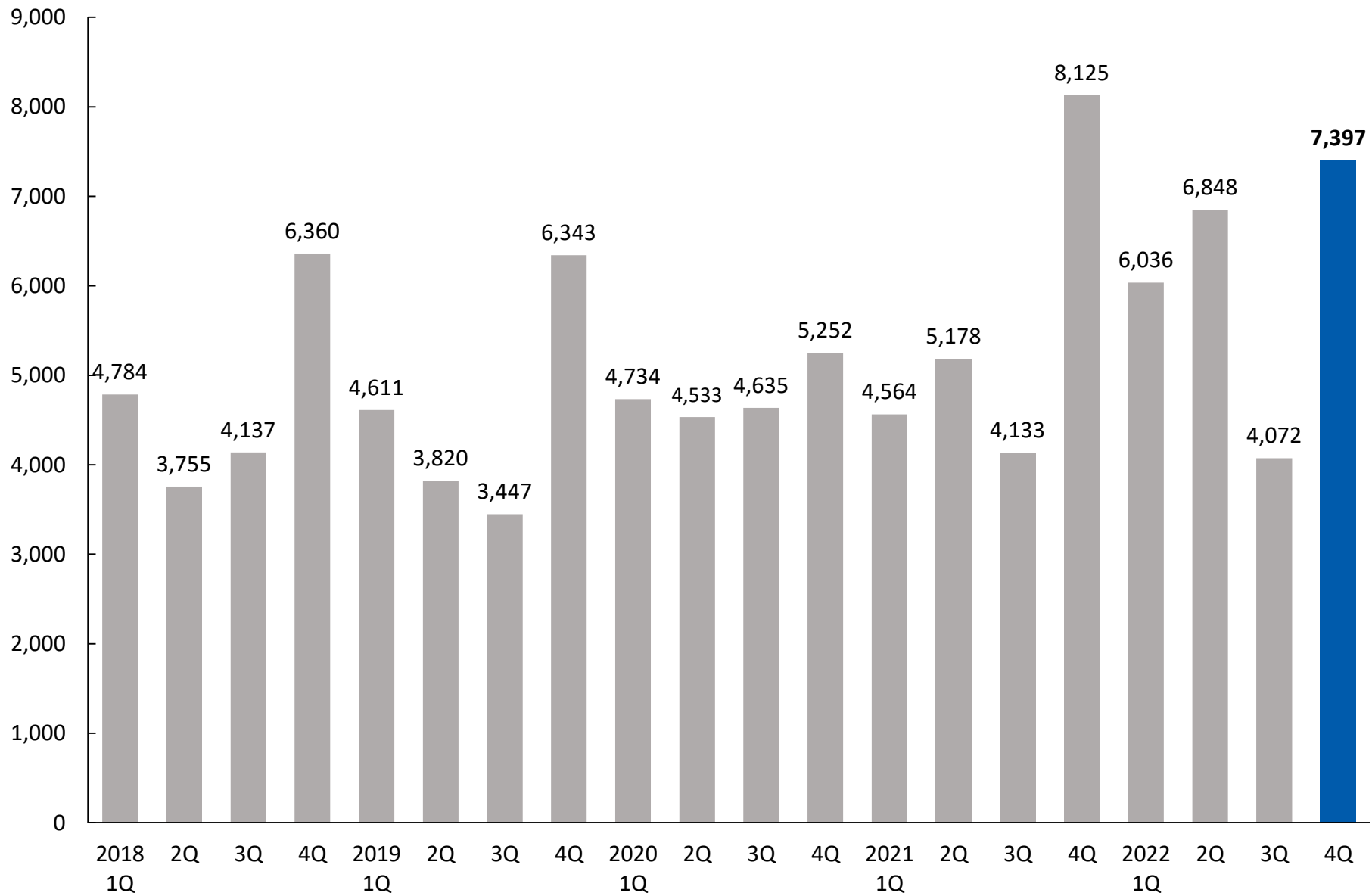
1972	電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
1980	インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
1989	液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
1990	本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転 スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
1994	エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
1995	インジェクション成形品の製造・販売を開始
2001	半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
2004	JASDAQ市場に株式を上場
2008	TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

2009	第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
2013	アプリアテクノロジー株式会社を子会社化 ハノイ省ハノイ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
2015	第三者割当増資により、資本金16億1,683万円へ増資
2016	タツモ岡山技術センターを開設
2017	株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化
2018	東京証券取引所市場第一部へ市場変更 新株式発行により、資本金27億2,406万円へ増資
2019	本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
2020	アプリアテクノロジー株式会社を吸収合併
2022	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行

連結売上高推移

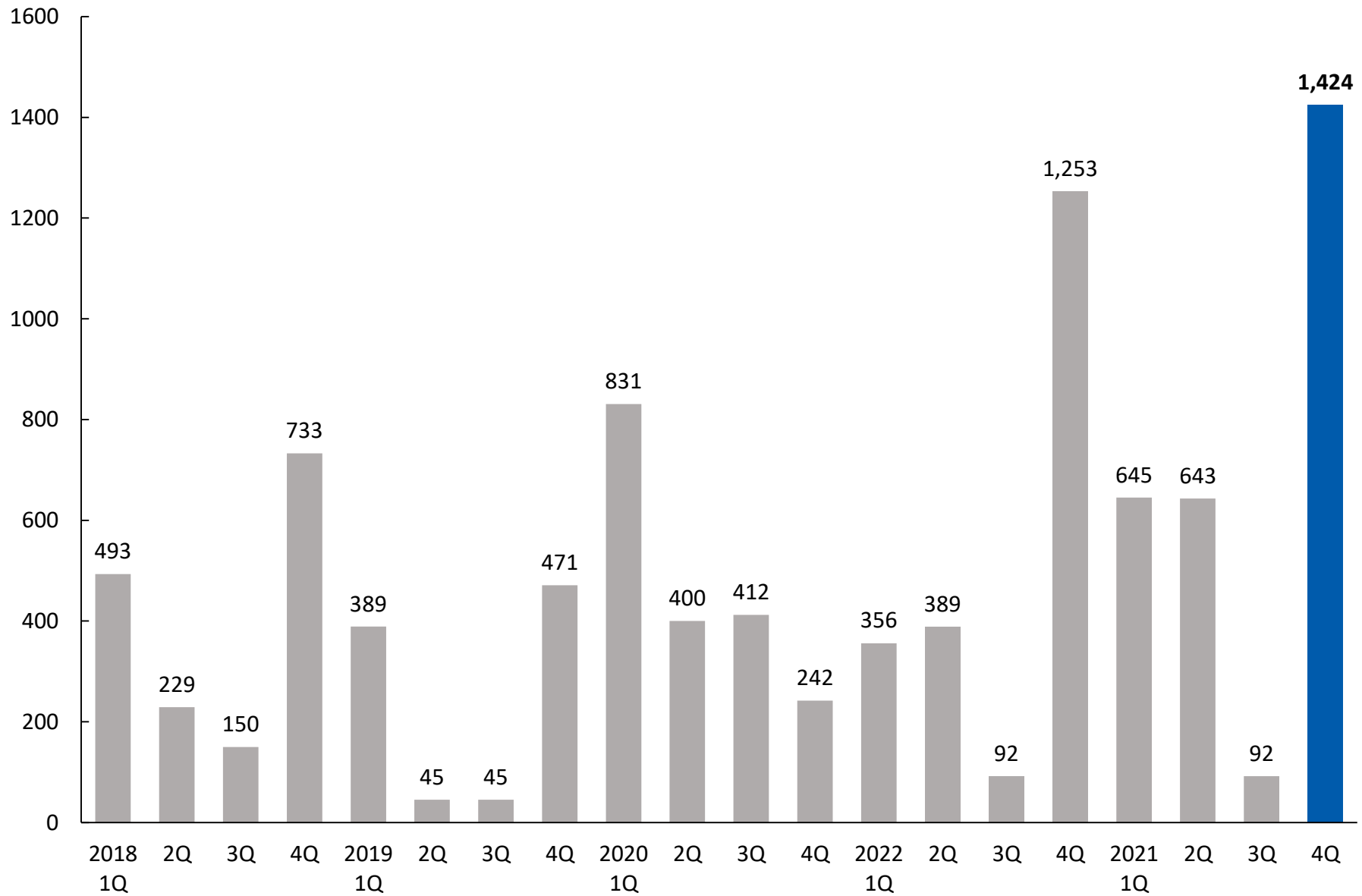
TAZMO

単位：百万円

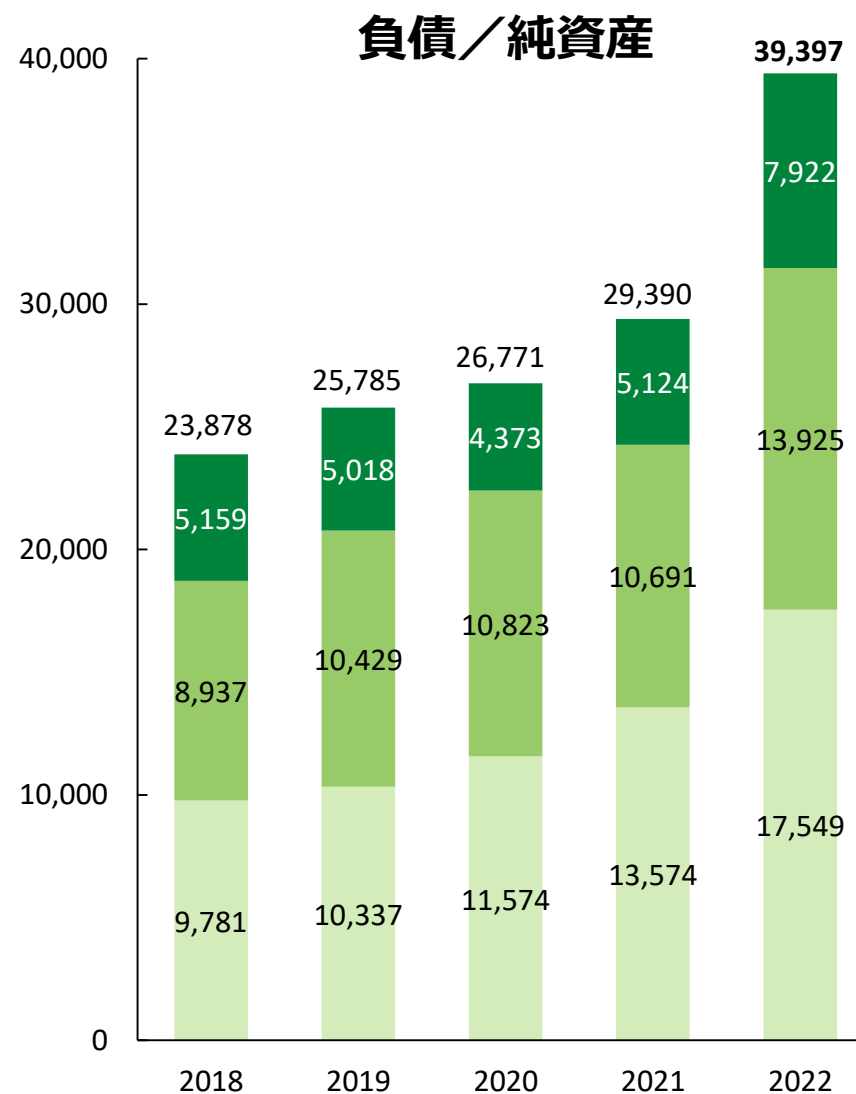
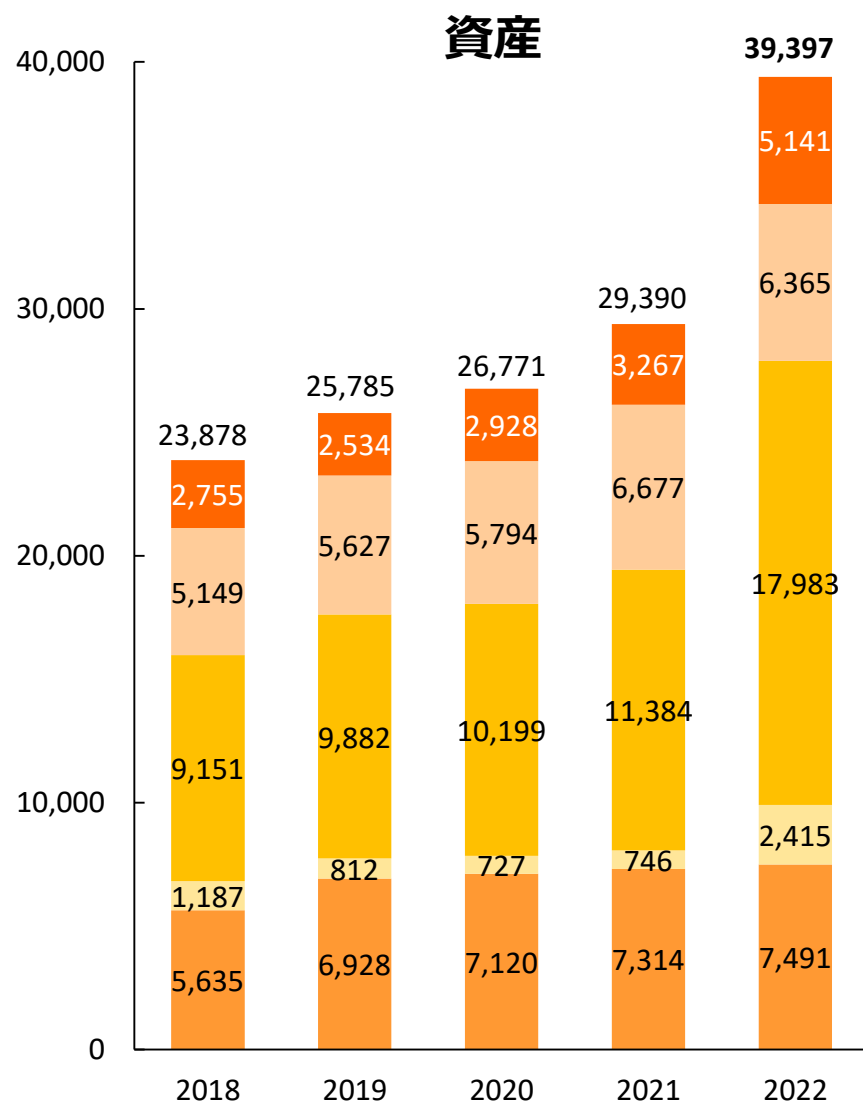


連結営業利益推移

単位：百万円



単位：百万円

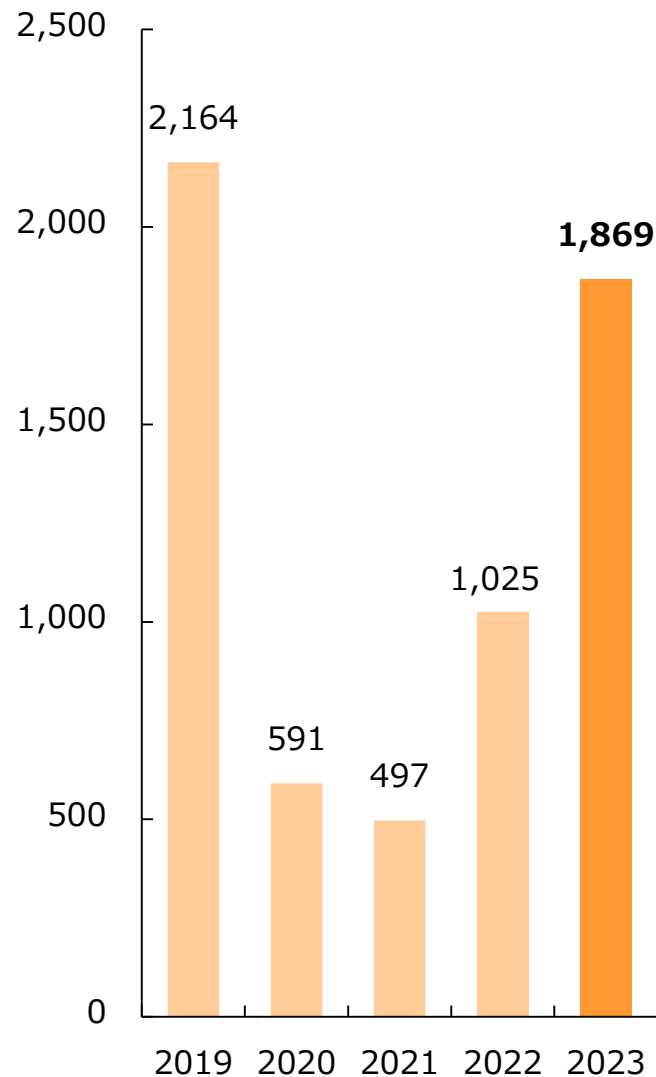


- 固定資産
- たな卸資産
- 現金同等物
- その他流動資産
- 売掛債権

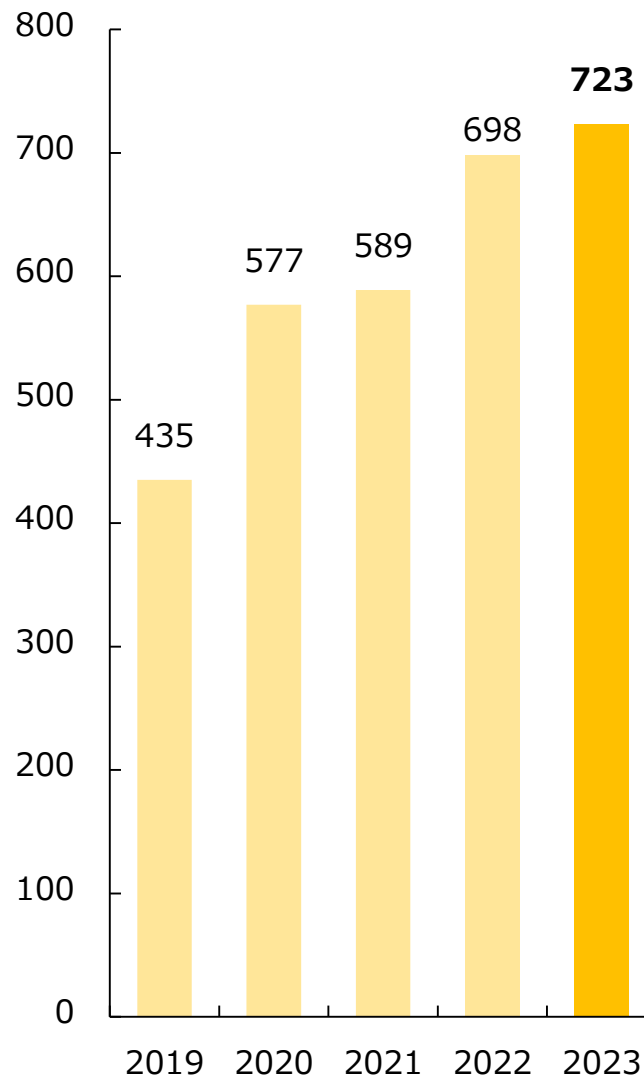
- 純資産
- その他負債
- 有利子負債

単位：百万円

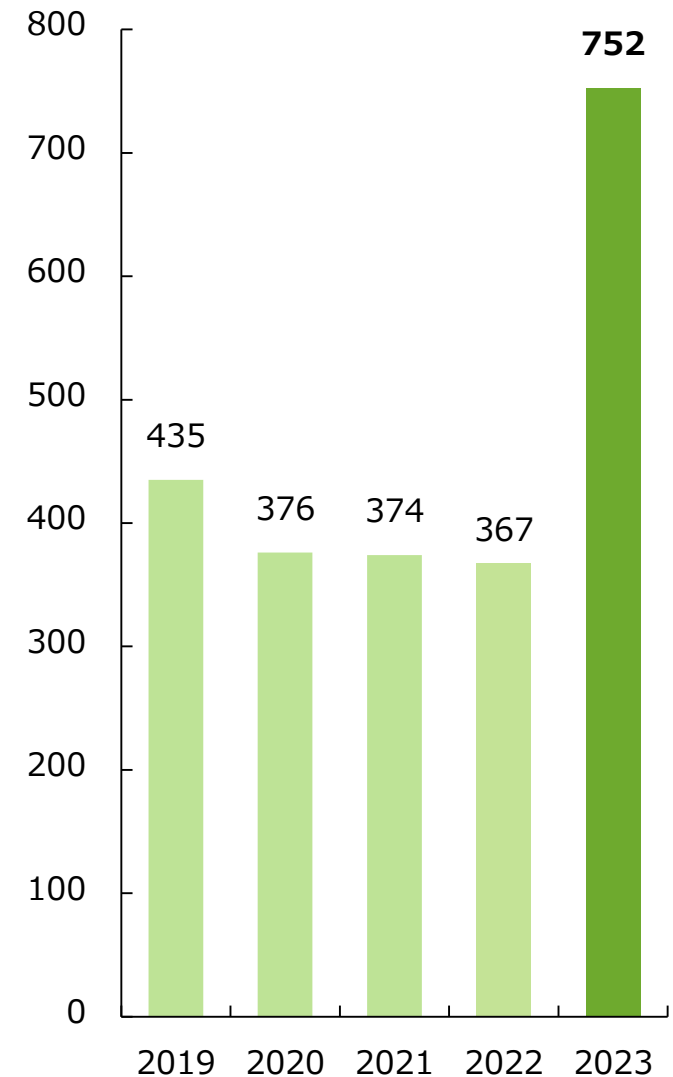
設備投資



減価償却費



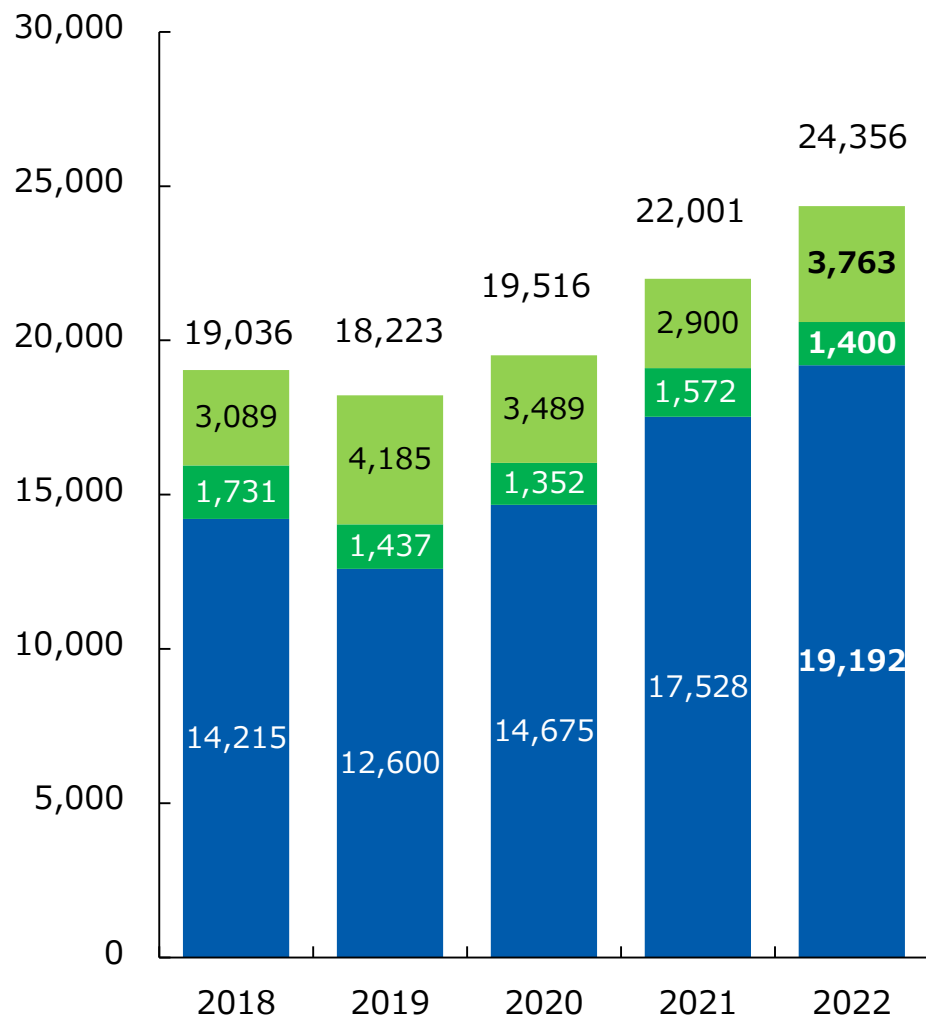
研究開発費



セグメント別 売上高・営業利益推移

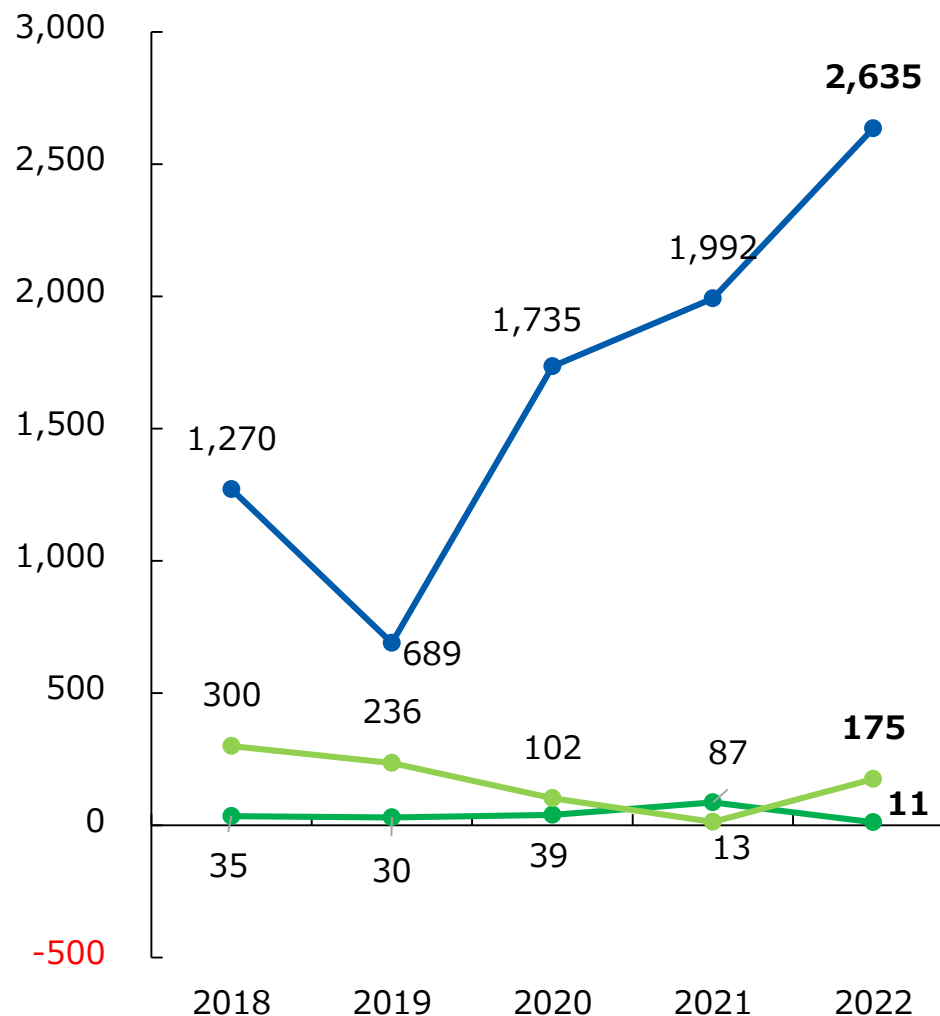
単位：百万円

売上高推移



■ プロセス機器事業 ■ 金型・樹脂成形事業
■ 表面処理用機器事業

営業利益推移



● プロセス機器事業 ● 金型・樹脂成形事業
● 表面処理機器事業

本資料の取扱上の注意

本資料は、2023年2月13日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載された内容に基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

TEL 086-239-5000

FAX 086-239-5100

Email keiki@tazmo.co.jp



TAZMO